

CFG 3025 US

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出願年月日
Date of Application: 2001年 2月 22日

出願番号
Application Number: 特願 2001-047297

[ST.10/C]: [JP 2001-047297]

出願人
Applicant(s): キヤノン株式会社

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

2002年 3月 15日

RECEIVED
TECHNOLOGY CENTER 2002
MAY - 8 2002
2002-3016804



出証番号 出証特 2002-3016804

【書類名】 特許願

【整理番号】 4287037

【提出日】 平成13年 2月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 26/10
G02B 27/17
G11B 21/10
G01L 3/10
B62D 5/04
B81B 3/00

【発明の名称】 マイクロ構造体、マイクロ力学量センサ、マイクロアクチュエータ、マイクロ光偏向器、光走査型ディスプレイ、及びそれらの製造方法

【請求項の数】 27

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

【氏名】 安田 進

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

【氏名】 八木 隆行

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

【氏名】 加藤 貴久

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

【氏名】 廣瀬 太

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100086483

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 一男

【電話番号】 0471-91-6934

【手数料の表示】

【納付方法】 予納

【予納台帳番号】 012036

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704371

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 マイクロ構造体、マイクロ力学量センサ、マイクロアクチュエータ、マイクロ光偏向器、光走査型ディスプレイ、及びそれらの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、少なくとも一つ以上の揺動体を有し、前記揺動体が1本以上のトーションバーによって前記基板に対して弾性的に揺動自由に支持されているマイクロ構造体において、前記トーションバーは、横断面形状が略多角形であり、その少なくとも2つ以上の内角が180度よりも大きく、また、前記横断面形状が点対称形状であることを特徴とするマイクロ構造体。

【請求項2】 前記トーションバーの材質が単結晶材料から成ることを特徴とする請求項1に記載のマイクロ構造体。

【請求項3】 前記単結晶材料がシリコン単結晶であることを特徴とする請求項2に記載のマイクロ構造体。

【請求項4】 前記基板、揺動体、トーションバーが共通の基板から一体的に形成されていることを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項5】 (100)シリコン基板が用いられ、トーションバーが該シリコン基板の異方性エッチングで形成されて、その外面を画する該(100)シリコン基板面に対する斜面が(111)面であることを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項6】 前記基板或いは揺動体に繋がるトーションバーの付け根部の外面を画する該(100)シリコン基板面に対する面が(111)面であることを特徴とする請求項5に記載のマイクロ構造体。

【請求項7】 前記トーションバーの横断面形状がX字状であることを特徴とする請求項5または6に記載のマイクロ構造体。

【請求項8】 平板状基板が用いられ、トーションバーが該平板状基板の深堀りエッチングで形成されて、その外面を画する面が該平板状基板面とこの面に対する垂直面或いは平行面から成ることを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項9】前記トーションバーの横断面形状がX字状、十字状、H字状、N字状、或いはS字状であることを特徴とする請求項1乃至8の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項10】前記トーションバーの角部が等方性エッティングで軽く丸くされて、そこへの応力集中が緩和されていることを特徴とする請求項1乃至9の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項11】前記揺動体が一つであり、直線に沿って伸びた一つないし一対のトーションバーによって該揺動体が前記基板に対して弾性的に略該直線の回りに揺動自由に支持されていることを特徴とする請求項1乃至10の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項12】前記揺動体が複数であり、該複数の揺動体が入れ子式に配置され、各揺動体が、各直線に沿って伸びた一対のトーションバーによって、その外側の揺動体或いは前記基板に対して弾性的に略該各直線の回りに揺動自由に支持されていることを特徴とする請求項1乃至10の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項13】前記各直線が互いに角度を成して伸びていることを特徴とする請求項12に記載のマイクロ構造体。

【請求項14】前記角度が90度であることを特徴とする請求項13に記載のマイクロ構造体。

【請求項15】前記揺動体が複数であり、該複数の揺動体がトーションバーを介在させて直列的に配置され、最も外側の揺動体が前記基板にトーションバーを介在させて支持されていることを特徴とする請求項1乃至10の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項16】請求項1乃至15の何れかに記載のマイクロ構造体と、前記基板と前記揺動体の相対変位を検出する変位検出手段を有することを特徴とするマイクロ力学量センサ。

【請求項17】請求項1乃至15の何れかに記載のマイクロ構造体と、前記揺動体を前記基板に対して相対的に駆動する駆動手段を有することを特徴とするマイクロアクチュエータ。

【請求項18】前記駆動手段が、固定コアと、該固定コアを周回するコイルと、前記揺動体に接合された可動コアからなる電磁アクチュエータであることを特徴とする請求項17に記載のマイクロアクチュエータ。

【請求項19】請求項1乃至15の何れかに記載のマイクロ構造体と、前記揺動体を前記基板に対して相対的に駆動する駆動手段と、前記揺動体に設けられた光反射手段を有することを特徴とするマイクロ光偏向器。

【請求項20】前記駆動手段が、固定コアと、該固定コアを周回するコイルと、前記揺動体に接合された可動コアからなる電磁アクチュエータであることを特徴とする請求項19に記載のマイクロ光偏向器。

【請求項21】前記光反射手段が、光反射面或いは回折格子であることを特徴とする請求項19または20に記載のマイクロ光偏向器。

【請求項22】請求項19乃至21の何れかに記載のマイクロ光偏向器と、変調可能な光源と、前記光源の変調と前記マイクロ光偏向器の揺動体の動作を制御する制御手段を有することを特徴とする光走査型ディスプレイ。

【請求項23】請求項5乃至7の何れかに記載のマイクロ構造体の製造方法であって、(100)シリコン基板の両面にマスク層を成膜する工程と、前記両面のマスク層を前記揺動体とトーションバーの形態に応じてパターニングする工程と、前記(100)シリコン基板を異方性エッチングする工程を含むことを特徴とするマイクロ構造体の製造方法。

【請求項24】前記異方性エッチングをアルカリ溶液を用いて行うことを特徴とする請求項23に記載のマイクロ構造体の製造方法。

【請求項25】請求項8または9に記載のマイクロ構造体の製造方法であって、基板の両面にマスク層を成膜する工程と、前記両面のマスク層を前記揺動体とトーションバーの形態に応じてパターニングする工程と、前記基板を片面より深堀りエッチングする工程と、前記基板を他面より深堀りエッチングする工程を含むことを特徴とするマイクロ構造体の製造方法。

【請求項26】前記基板がシリコン基板であることを特徴とする請求項25に記載のマイクロ構造体の製造方法。

【請求項27】前記トーションバーの角部を軽く等方性エッチングして、そこ

を丸くし、そこへの応力集中を緩和する工程を更に含むことを特徴とする請求項23乃至26の何れかに記載のマイクロ構造体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、マイクロマシンないしマイクロ構造体の分野に関するものである。より詳しくは、軸回りに揺動する部材を有するマイクロ力学量センサ、マイクロアクチュエータ、マイクロ光偏向器等に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

機械要素を小型化しようとすると、体積力よりも、表面力の占める割合が大きくなり、摩擦の影響が通常の大きさの機械よりも大きくなることは良く知られている。そのため、マイクロマシンの設計においては、摺動部や回転部を極力少なくするように考慮するのが一般的である。

【0003】

軸回りに揺動する部材を有する光偏向器の従来例を説明する。図24は、米国特許第4317611号明細書に開示された光偏向器の斜視図を示している。図25は、その内部構造を説明するために、上記光偏向器を分解して表示した図である。また、図26と図27は、それぞれ、図24の切断線1003と1006におけるシリコン薄板1020の断面図を示している。

【0004】

上記光偏向器において、絶縁性材料からなる基板1010には、凹み部1012が形成されている。凹み部1012の底部には、一対の駆動電極1014、1016およびミラー支持部1032が配置されている。シリコン薄板1020には、トーションバー1022、1024とミラー1030が一体に形成されている。ミラー1030は、表面に光の反射率の高い物質がコーティングされており、トーションバー1022、1024により揺動自由に支持されている。そして、シリコン薄板1020は、駆動電極1014、1016と所定の間隔を保つように基板1010上に対抗配置されている。

【0005】

ここで、シリコン薄板1020は、電気的に接地されている。従って、駆動電極1014、1016に交互に電圧を印加することで、ミラー1030に静電引力を作用させて、ミラー1030をトーションバー1022、1024の長軸の回りに揺動させられる。

【0006】

トーションバー1022、1024の断面形状は、図27に示すような台形である。ところが、この様な断面形状のトーションバーを有するマイクロ構造体は、トーションバーが撓みやすいため、外部の振動を拾ってしまったり、トーションバーの軸がぶれてしまい、正確な駆動ができないという問題点があった。

【0007】

そのため、この様な光偏向器を光走査型ディスプレイに適用した場合に、外部振動によって像がぶれたり、スポット形状が変化してしまうという問題点があった。これは、光走査型ディスプレイを持ち運び容易な形態にした場合に、より大きな問題となる。

【0008】

そこで、トーションバーを撓みにくくするために、次のような構造が提案されている。図28は、10th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators (Transducers '99) pp.1002-1005にて開示されたハードディスクヘッド用ジンバルである。このジンバルは、ハードディスクヘッド用サスペンションの先端に取り付けられ、磁気ヘッドにロールとピッチの動きを弾性的に許容させるためのものである。ジンバル2020は、内側にロールトーションバー2022、2024で回転自由に支持された支持棒2031を有している。また、支持棒2031の内側には、ピッチトーションバー2026、2028で回転自由に支持されたヘッド支持体2030が形成されている。ロールトーションバー2022、2024とピッチトーションバー2026、2028のねじれの軸（図28の直交する鎖線参照）は、互いに直交しており、それぞれ、ヘッド支持体2030のロールとピッチの動きを担当している。

【0009】

図29は、図28中の切断線2006における断面図である。図29に示すように、トーションバー2022の断面形状はT字形状をしており、また、ジンバル2020はリブを有する構造になっている。

【0010】

図30を用いて、本ジンバルの作製工程を説明する。先ず、型取り用シリコンウエハー2091に、ICP-RIE(誘導結合プラズマ反応性イオンエッティング)のようなエッティング法を用いて、垂直エッティングを行う(a)。この型取り用シリコンウエハー2091は、再利用が可能である。次に、型取り用シリコンウエハー2091の上に、シリコン酸化膜とリン酸化ガラスからなる犠牲層2092を成膜する(b)。続いて、構造体となるポリシリコン層2093を成膜する(c)。そして、このポリシリコン層2093のパターニングを行う(d)。最後に、犠牲層2092を除去し、パターニングされたパッド2095にエポキシ樹脂2094でポリシリコン層2093を接着する(e)。

【0011】

この様にして作製されたT字断面を有するトーションバーは、円断面や長方形断面のような断面形状を有するトーションバーと比べて、断面二次極モーメントJが小さいわりに、断面二次モーメントIが大きいという特徴がある。そのため、比較的ねじれやすい割りに、撓みにくいトーションバーを提供できる。つまり、ねじれ方向に十分なコンプライアンスを確保しながら、ねじれの軸に垂直な方向には剛性の高いトーションバーを提供できる。

【0012】

また、必要なコンプライアンスや許容ねじれ角を得るために長さが短いトーションバーを提供できるため、より小型化できるという利点もある。

【0013】

こうして、このT字断面を有するトーションバーを用いることで、ロール、ピッチ方向に十分なコンプライアンスを持ち、その他の方向には十分な剛性を有し、より小型化が可能なマイクロジンバルを提供できる。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、このマイクロ構造体には、次のような問題点があった。

1. T字断面形状のトーションバーは、ねじれの軸中心が、揺動体の重心からずれてしまう。このことを、図を使用して説明する。図22は、一端を固定されたT字断面のトーションバー922の他端に揺動体930が支持されている様子を示している。また、図23は、図22の矢印方向から見た側面図を示している。図23に示すように、T字断面のトーションバー922のねじれの中心901と揺動体930の重心902は、位置がずれている。そのため、揺動すると、ねじれの軸に垂直な方向に加振力が生じてしまう。このことは、マイクロ力学量センサにおいてはノイズの原因となり、マイクロアクチュエータにおいては、不要な方向の動きとなり、マイクロ光偏向器においては、走査光のぶれの原因となっていた。

【0015】

2. ポリシリコンは、単結晶シリコンに比べて内部損失が大きいため、機械的なQ値が低くなってしまう。そのため、機械的な共振を利用して駆動する際に、振動振幅を大きくできない。また、損失が大きいためエネルギー効率が低い。

【0016】

本発明の目的は、この様な問題点を解決した、軸回りに揺動する部材を有するマイクロ力学量センサ、マイクロアクチュエータ、マイクロ光偏向器等に適用できるマイクロマシンないしマイクロ構造体、その製造方法を提供することにある。

【0017】

【課題を解決するための手段】

上記問題点を解決するための本発明のマイクロ構造体は、基板と、少なくとも一つ以上の揺動体を有し、前記揺動体が1本以上のトーションバーによって前記基板に対して弾性的に揺動自由に支持されているマイクロ構造体であって、前記トーションバーは、横断面形状が略多角形であり、その少なくとも2つ以上の内角が180度よりも大きく、また、前記横断面形状が点対称形状であることを特徴とする。

【0018】

この基本構成に基づいて、以下の如きより具体的な形態が可能である。

典型的には、前記トーションバーの材質がシリコン単結晶、水晶などの単結晶材料から成る。また、前記基板、揺動体、トーションバーは、共通のシリコン単結晶、水晶などの単結晶材料基板からエッチングなどで一体的に形成され得る。

【0019】

また、(100)シリコン基板が用いられて、トーションバーが該(100)シリコン基板の異方性エッチングで形成されて、その外面を画する該(100)基板面に対する斜面が(111)面である様にできる。この際、前記基板或いは揺動体に繋がるトーションバーの付け根部の外面を画する(100)基板面に対する面も、(111)面である様にできる。(111)面は高精度且つ滑らかに形成されるので、作製されたトーションバーは破断し難いものとなる。更に、トーションバーの付け根部分の面も(111)斜面とすれば、ここへの応力集中が緩和できて、トーションバーの信頼性を高められる。

【0020】

また、シリコンなどの平板状基板が用いられて、トーションバーが該平板状基板のICP-RIEなどを用いる深堀りエッチングで形成されて、その外面を画する面が該平板状基板面とこの面に対する垂直面或いは平行面から成る様にもできる。

【0021】

少なくとも2つの内角が180度よりも大きい略多角形のトーションバーの横断面形状としては、X字状、十字状、H字状、N字状(図21(a)参照)、S字状(図21(b)参照)などの形状がある。

【0022】

前記トーションバーの角部(急峻な楔部分など)が等方性エッチングで軽く丸くされて、そこへの応力集中が緩和されてもよい。

【0023】

マイクロ構造体の形態としては、前記揺動体が一つであり、直線に沿って伸びた一つないし一対のトーションバーによって該揺動体が前記基板に対して弾性的に略該直線の回りに揺動自由に支持されている形態を探り得る。一対のトーションバーの形態は後述の実施例に説明されているが、揺動体が充分軽量で一つトー

ションバーで支障なく揺動自由に支持され得る場合には、こうした形態も用途に応じて使用できる。

【0024】

他のマイクロ構造体の形態としては、前記揺動体が複数であり、該複数の揺動体が入れ子式に配置され、各揺動体が、各直線に沿って伸びた一対のトーションバーによって、その外側の揺動体或いは前記基板に対して弾性的に略該各直線の回りに揺動自由に支持されている形態も採り得る。2つの揺動体が入れ子式に配置された例は図28に示されている。必要であれば、3つ以上の揺動体が入れ子式に配置された形態も実現できる。前記各直線が互いに成す角度は、典型的には90度であるが（図28の例参照）、これも、必要であれば90度以外の角度であってもよい。

【0025】

更なる他のマイクロ構造体の形態としては、前記揺動体が複数であり、該複数の揺動体がトーションバーを介在させて直列的に配置され、最も外側の揺動体が前記基板にトーションバーを介在させて支持されている形態も採り得る。例えば、比較的小質量の揺動体をトーションバーを介在させて比較的大質量の揺動体で挟み、両側の大質量の揺動体をトーションバーを介在させて基板に繋げ、これら3つのトーションバーを一直線に沿って伸びる形態として、この形態において、大質量の揺動体の駆動で小質量の揺動体を間接的に駆動する。いずれにせよ、本発明のマイクロ構造体は、トーションバーの横断面形状が略多角形であり、その少なくとも2つ以上の内角が180度よりも大きく、また、前記横断面形状が点対称形状であることに特徴があり、その形態は用途に応じて種々のものであり得る。

【0026】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロ力学量センサは、上記のマイクロ構造体と、基板と揺動体の相対変位を検出する変位検出手段を有することを特徴とする。変位検出手段としては、従来公知のものを使用できて、例えば、静電容量の変化を電圧変化で検知して基板と揺動体の相対変位を検出するものがある。その具体例としては、特開平8-145717、特開2000-656

64、特開2000-292434号公報などに開示されている。

【0027】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロアクチュエータは、上記のマイクロ構造体と、前記揺動体を前記基板に対して相対的に駆動する駆動手段を有することを特徴とする。前記駆動手段としては、固定コアと、該固定コア（軟磁性体で形成されたりする）を周回するコイルと、前記揺動体に接合された可動コア（軟磁性体或いは硬磁性体の永久磁石で形成されたりする。両者では駆動原理が異なり、前者では、軟磁性体の磁極は決まっておらず、固定コアに磁束が発生する時には磁気回路の磁束を切る軟磁性体の断面積の増す方向に磁束内へ軟磁性体が吸引される駆動力が起り、磁束消滅時にはそれから解放されるのに対して、後者では、硬磁性体の磁極は決まっており、異或いは同磁極間の磁力（吸引力或いは反発力）が駆動力である）からなる電磁アクチュエータであったり、静電引力を利用するものであったりする。

【0028】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロ光偏向器は、上記のマイクロ構造体と、揺動体を基板に対して相対的に駆動する駆動手段と、前記揺動体に設けられた光反射手段を有することを特徴とする。駆動手段については、上で述べた通りである。光反射手段としては、光反射面或いは回折格子があり、後者では1つのビームを複数のビーム（回折光）として偏向することもできる。

【0029】

更に、上記問題点を解決するための本発明の光走査型ディスプレイは、上記のマイクロ光偏向器と、変調可能な光源（半導体レーザなど）と、前記光源の変調と前記マイクロ光偏向器の揺動体の動作を制御する制御手段を有することを特徴とする。

【0030】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロ構造体の製造方法は、（100）シリコン基板の両面にマスク層を成膜する工程と、前記両面のマスク層を前記揺動体とトーションバーの形態に応じてパターニングする工程と、前記（100）シリコン基板をアルカリ溶液などを用いて異方性エッチングする工程を

含むことを特徴とする。

【0031】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロ構造体の他の製造方法は、シリコン基板などの材料基板の両面にマスク層を成膜する工程と、前記両面のマスク層を前記揺動体とトーションバーの形態に応じてパターニングする工程と、前記材料基板を片面よりICP-RIEなどを用いて深堀りエッチングする工程と、前記材料基板を他面よりICP-RIEなどを用いて深堀りエッチングする工程を含むことを特徴とする。

【0032】

これらのマイクロ構造体の製造方法において、前記トーションバーの角部を軽く等方性エッチングして、そこを丸くし、そこへの応力集中を緩和してもよい。

【0033】

【作用】

本発明のマイクロ構造体の作用について説明する。

本発明のマイクロ構造体においては、上述したように、トーションバーの横断面形状を略多角形とし、その2つ以上の内角が180度より大きい形状とし、また、前記横断面形状が点対称形状である様にしている。図21は、本発明のトーションバーの断面形状の例を示している。(a)は、2つの内角が270°、4つの内角が135°、4つの内角が90°の10角形形状を示している。また、(b)は、4つの内角が270°、8つの内角が90°の12角形形状を示している。

【0034】

トーションバーの断面形状をこの様にすることで、比較的ねじれやすくて、ねじれの軸に角度を成す方向に対して撓みにくい構造を実現することができる。なぜなら、こうした方向に撓ませようとしても、材料が比較的厚い部分があって該厚い部分が撓みを阻止しようと働くからである。さらに、これらは、点対称形状であるので、ねじれの軸の中心を揺動体の重心と一致させることができる。そのため、揺動時にねじれの軸に垂直な方向の加振力が生じないマイクロ構造体を実現できる。

【0035】

加えて、素材として単結晶材料を使用する場合には、機械的なQ値の高い構造を実現できる。単結晶材料としては、入手の容易で機械特性に優れた（すなわち、比較的軽量でありながら物理的強度、耐性、寿命に優れた）単結晶シリコンを使用するのが好適である。

【0036】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態を明らかにすべく、図面を参照しつつ実施例を説明する。

【0037】

[実施例1]

図1は、本発明の実施例1のマイクロ光偏向器を説明するための斜視図である。図2は、内部構造を説明するために、上記マイクロ光偏向器を分解して示した図である。図3は、図1の切断線106におけるシリコン単結晶薄板120の断面を示している。

【0038】

実施例1のマイクロ光偏向器において、ガラス基板110には、凹み部112が形成されている。凹み部112の底部には、一対の駆動電極114、116および三角柱状のミラー支持部132が配置されている。ミラー支持部132は、可能であれば、無くしてもよい。シリコン単結晶薄板120には、バルクマイクロマシニング技術により、トーションバー122、124とミラー130が、一体に形成されている。本実施例の特徴であるトーションバー122、124は、図3に示すように、断面形状がX字形状になっている。この形状は、図3より明らかなように、4つの内角が180度よりも大きい12角形であり、また、点対称である。

【0039】

ミラー130は、平板の表面に光の反射率の高い物質がコーティングされて形成されており、X字形状のトーションバー122、124によりこの長軸の回りに揺動自由に支持されている。そして、シリコン単結晶薄板120は、ミラー1

30が駆動電極114、116と所定の間隔を保つようにガラス基板110上に対抗配置されている。トーションバー122、124の長軸に沿ったミラー130の下面是ミラー支持部132の頂線部に接していて、該頂線部に沿う揺動軸の回りでミラー130が揺動可能になっている。

【0040】

シリコン単結晶薄板120は、電気的に接地されている。従って、駆動電極114、116に交互に電圧を印加することで、ミラー130に静電引力を作用させて上記揺動軸の回りにミラー130を揺動させることができる。駆動力は静電引力に限らず、磁気力などを使うこともできる。この場合は、駆動電極の代わりに電磁石を設置してミラー130の下面に硬磁性材料の永久磁石などを固定する構成をとることになる。

【0041】

上記光偏向器の作製法について、図6と図7を用いて、以下に詳しく述べる。図6(a)～(g)は図1の切断線106における断面を表し、図7(a)～(e)は、図2の切断線109における断面を表している。

【0042】

先ず、図6に沿ってシリコン単結晶薄板120の加工について述べる。

【0043】

1. シリコン単結晶薄板120の両面に、マスク層150（例えば、 SiO_2 や低圧化学気相成長法で作製した窒化シリコン等）を成膜する。シリコン単結晶薄板120には、(100)基板を使用する。そして、フォトリソグラフィ技術で、マスク層150のパターニングを行う(a)。このパターニングに使用するマスクパターンを図4に示す。図4に示すマスクパターンは、トーションバー122、124とミラー130の外形に沿って W_a の幅を有する開口部191が形成されており、また、幅 W_b のトーションバーの長手方向の中心線に沿って W_g の幅を有する開口部190が形成されている。

【0044】

2. KOHのようなアルカリ溶液である異方性エッティング溶液を用いて、シリコン単結晶薄板120の両面からエッティングを行う。シリコンの異方性エッティング

は、(100)面で速く進み、(111)面で遅く進むため、エッティングは、まず、掘り進むにつれて開口部が狭くなるように進行する(b)。

【0045】

3. W_g の幅を有する開口部190においては、基板120の中央に達する前にすべての面が(111)面になりエッティングがストップするため、V字状の溝(図3に示す様に、深さ d_g で、幅 W_g である)が形成される。また、 W_a の幅を有する開口部191においては、基板120を貫通するまでエッティングが進行する(c)。図5に示すように、(111)面は、(100)面に対して、54.7度の角度を有するため、開口部の幅wとV溝の深さdの関係は、 $d=w/2 \cdot \tan 54.7^\circ$ である。従って、ここでは、 $W_g < 2t/\tan 54.7^\circ$ 、 $W_a > 2t/\tan 54.7^\circ$ の関係を満たしている。ここで、tはシリコン単結晶薄板120の厚みである。

【0046】

4. 開口部191の上下からの穴が貫通したあとは、エッティングは側方に進んでいく(d、e)。

【0047】

5. (111)面に到達して、エッティングがストップする。このときトーションバー122、124の断面はX字形状になる(f)。図3に示す様に、このX字断面の側部のV溝の深さは k_b で、幅はtである。この際、(111)面は高精度且つ滑らかに形成されるので、作製されたX字形状のトーションバー122、124は破断し難いものとなる。更に、上記異方性エッティングにより、トーションバー122、124の付け根部分のV溝の面(図2(a)に122a、124aで示す)も図2(b)に示すように(111)斜面となるので、ここへの応力集中が緩和でき、トーションバーの信頼性を高め、ミラーの光偏向角を大きくできる。

【0048】

6. 上記異方性エッティング後、ガスや酸により等方性エッティングを行い、V溝の急峻な楔部分やトーションバーの角部の角を丸くしてもよい。こうすれば、これらの部分への応力集中を緩和できる。

【0049】

7. 次に、マスク層150を除去する(g)。

8. 最後に、ミラー130を洗浄し、表面に光反射膜を成膜する。

【0050】

続いて、図7に沿ってガラス基板110の加工法について述べる。

1. ガラス基板110の両面にマスク層151(レジスト等)を成膜する(a)。

【0051】

2. マスク層151をパターニングする(b)。三角柱状のミラー支持部132と凹み部112がエッティングで形成される様にパターニングする。

【0052】

3. 凹み部112の深さが $25\mu m$ になるように、エッティングを行う(c)。

このとき、三角柱状のミラー支持部132が形成される。

【0053】

4. マスク層151を除去し、凹み部112に所定のパターンの駆動電極114、116を形成する(d)。

【0054】

5. 図1に示すようなマイクロ光偏向器の形態になるように、シリコン単結晶薄板120とガラス基板110を接合する(e)。

【0055】

以上のように、本実施例の製造方法によれば、異方性エッティングを1度行うだけで、X字形状断面を有するトーションバー122、124を製造することができる。図3に示すように断面がX字形状になっている本実施例の光偏向器のトーションバー122(124)は、断面二次モーメントJが小さい割に、断面二次モーメントIが大きいという特徴がある。また、その横断面形状が点対称なので、揺動時にねじれの軸に垂直な方向の加振力が生じないマイクロ構造体を実現できる。

【0056】

本実施例によれば、単結晶シリコンをトーションバーの素材に使用することで、ポリシリコンに比べて、より壊れにくく、より小型化が可能で、共振駆動した

ときに振動振幅が大きくエネルギー効率の高い、機械的なQ値が大きなマイクロ構造体を実現できる。

【0057】

また、揺動したときにトーションバーの軸に垂直な方向に振動しにくいので、精度が高いマイクロ光偏向器を実現でき、機械的なQ値が高いために共振駆動したときに振動振幅が大きく、エネルギー効率の高いマイクロ光偏向器を実現できる。更に、本実施例の製造方法を用いることで、比較的容易にX字形状の断面を有するトーションバーを製造することができる。

【0058】

[実施例2]

図8は、本発明の実施例2の加速度センサを説明するための斜視図である。図9は、内部構造を説明するために、上記加速度センサを分解して示した図である。また、図10は、図8の切断線206における単結晶シリコン薄板220の断面を示している。

【0059】

本実施例の加速度センサにおいて、絶縁性基板210には、凹み部212が形成されている。凹み部212の底部には検出電極216が配置されている。シリコン薄板220には、一対のトーションバー222、224と可動部材230が、一体に形成されている。本実施例の特徴であるトーションバー222、224は、図10より分かるように、それぞれ、断面形状が十字形状になっている。これは、4つの内角が 270° 、8つの内角が 90° の12角形断面であり、点対称形状である。

【0060】

可動部材230は、トーションバー222、224によりその長軸の回りに揺動自由に支持されている。そして、シリコン単結晶薄板220は、検出電極216と所定の間隔を保つように絶縁性基板210上に対抗配置されており、電気的に接地されている。

【0061】

以上の構成において、シリコン単結晶薄板220に対して垂直な方向に加速度

が作用すると、可動部材230に慣性力が作用し、可動部材230は、トーションバー222、224の長軸の回りに回転変位する。可動部材230が回転変位すると、検出電極216との距離が変化するため、可動部材230と検出電極216の間の静電容量が変化する。そのため、検出電極216とシリコン単結晶薄板220の間の静電容量を従来周知の手段で検出することで、加速度を検出することができる。

【0062】

また逆に、検出電極216に電圧を印加すると、可動部材230と検出電極216の間に静電引力が作用し、可動部材230はトーションバー222、224の長軸の回りに揺動する。つまり、本実施例の加速度センサは、静電アクチュエータとしても使用することができる。

【0063】

上記加速度センサの作製法について、図11と図12を用いて、以下に詳しく述べる。図11(a)～(f)は図8の切断線206における断面を表し、図12(a)～(e)は図9の切断線209における断面を表している。

【0064】

先ず、図11に沿って単結晶シリコン薄板220の加工法を述べる。

- シリコン薄板220の両面に、マスク層250（例えば、レジスト等）を成膜し、図9に示すような形態のシリコン薄板220をエッチングで形成できるようなパターニングをフォトリソグラフィ技術で行う(a)。シリコン薄板220は、可能であれば、ポリシリコンであってもよいし、またその面方位は問わない。

【0065】

- ICP-RIEのような深堀りエッチング法を用いて、十字形状のトーションバー222、224と可動部材230と棒部以外のシリコン薄板部分を両面より一定の深さまで垂直エッチングを行う(b)。この深さは、断面が十字形状のトーションバー222、224の横棒部の厚さを規定するものである（この深さの約倍が横棒部の厚さとなる）。トーションバー222、224の縦棒部の厚さは次の新たなマスク層251の中央のストライプ部の幅で規定される。

【0066】

3. マスク層250を除去した後に、新たなマスク層251を成膜し、パターニングを行う（c）。

4. 再び、ICP-RIEのようなエッティング法を用いて、垂直エッティングを行う。まず、エッティングは図中下面から行い、2. で掘った場所の深さがシリコン薄板220の厚み中央に達するまで行う（d）。

5. 今度は、2. で掘った場所がシリコン薄板220を貫通するまで図中上面から垂直エッティングを行う（e）。

6. 最後に、マスク層251を除去する（f）。

【0067】

次に、図12に沿って絶縁性基板210の加工法を述べる。

1. 絶縁性基板210の両面にマスク層252（レジスト等）を成膜する（a）。

【0068】

2. 図9に示すような形態の絶縁性基板210をエッティングで形成できるようマスク層252をパターニングする（b）。

【0069】

3. 凹み部212の深さが $15\mu m$ になるように、エッティングを行い、凹み部212を形成する（c）。

【0070】

4. マスク層252を除去し、凹み部212に検出電極216を蒸着などで形成する（d）。

【0071】

5. 図8に示すような加速度センサの形態になるように、シリコン薄板220とガラス基板210を接合する（e）。

【0072】

本実施例の特徴である図10のような十字状の断面形状を有するトーションバーにおいても、断面二次モーメントJが小さいわりに、断面二次モーメントIが大きいという特徴がある。更に、T字断面のトーションバーと異なり、断面形

状を点対称にすることで、揺動したときに、ねじれの軸に垂直な方向の加振力が生じないマイクロ構造体を実現できる。

【0073】

また、単結晶シリコンを素材に使用したことで、ポリシリコンに比べて機械的なQ値が大きいマイクロ構造体を実現できる。また、揺動時に可動部がねじりの軸に垂直な方向に振動しにくくなるため、ノイズの少ない力学量センサを実現でき、従来よりも機械的なQ値が高く、感度の高い力学量センサを実現できる。

【0074】

また、本実施例によれば、揺動時に可動部がねじりの軸に垂直な方向に振動しにくいため、動きの精度が高いマイクロアクチュエータを実現でき、従来よりも機械的なQ値が高いため、共振駆動を行なったときに振幅を大きくすることができ、また、エネルギー効率の高いマイクロアクチュエータを実現できる。

【0075】

更に、本実施例によれば、比較的容易に本発明のマイクロ構造体を製造することができる。

【0076】

[実施例3]

図13は、本発明の実施例3のマイクロ光偏向器を説明するための斜視図を示している。図14と図15は、それぞれ上面図と側面図である。図15においては、分かりやすくするために、シリコン単結晶薄板320の一部を切断して示している。図16は、本実施例の特徴であるトーションバーの構造を説明するための、図13の切断線306におけるシリコン単結晶薄板320の断面図を示している。

【0077】

本実施例のマイクロ光偏向器において、シリコン単結晶薄板320には、バルクマイクロマシニング技術により、トーションバー328、329とミラー330が、一体に形成されている。ミラー330の端には、軟磁性体材料からなる可動コア341が固定されている。本実施例の特徴であるトーションバー328、329は、図16の断面図に示すように、断面形状がH字形状となっている。こ

れは、4つの内角が 270° 、8つの内角が 90° の12角形であり、点対称形状である。

【0078】

ミラー330は、表面に光の反射率の高い物質がコーティングされており、トーションバー328、329によりその長軸であるねじり軸の回りに揺動自在に支持されている。

【0079】

ガラス基板340の上には、図14で示す形状の軟磁性体材料からなる固定コア342が配置されており、この固定コア342をコイル345が周回している。そして、シリコン単結晶薄板320とガラス基板340は、可動コア341と固定コア342のほぼ平行に対向する面が、所定の間隔を保つように接合されている。すなわち、ミラー330が揺動するときに、これら対向する面がほぼ平行状態を保ったままその重なり面積（可動コア341が、固定コア342で発生した磁束を切る断面積）が変化する様になっている。可動コア341と固定コア342で2つの間隙を含む閉じた直列磁気回路が形成される。

【0080】

図17を用いて、本実施例の光偏向器の動作について説明する。

コイル345に通電すると、固定コア342が励磁される。図17では、固定コア342の中手前側がN極に、奥側がS極に励磁されている様子を表している。すると、可動コア341は、上記対向面の重なり面積が増す方向（固定コア342で発生した磁束路に吸引される方向）、即ち図17の矢印の方向に引き付けられる。可動コア341と固定コア342は、図15に示すように、上記対向面の重なり面積が増加できる様に非通電時には高さが異なる状態で配置されているので、トーションバー328、329の回りに左回りの回転モーメントが生じる。ミラー330の共振周波数に合わせてコイル345への通電をON/OFFすると、ミラー330がトーションバー328、329の回りに共振を起こす。この状態でミラー330に光線を入射することで、光の走査を行うことができる。

【0081】

次に、本光偏向器の作製方法を説明する。

まず、図18を用いて、シリコン単結晶薄板320の加工方法を説明する。図中左側は、図13の切断線306における断面図であり、右側は、切断線309における断面図である。

【0082】

1. 先ず、シリコン単結晶薄板320の片面に、種電極層360を成膜する。

(a)。

【0083】

2. 種電極層360の上に、厚膜レジスト層361（例えば、MicroChem社製SU-8）を成膜し、フォトリソグラフィ技術で可動コア341形成用のパターンングを行う（b）。

【0084】

3. 軟磁性体層362を種電極層360の上に電解メッキで成膜する（c）。

【0085】

4. 厚膜レジスト層361及び種電極層360を除去する（d）。軟磁性体層362の下の種電極層360はそのまま残る。

【0086】

5. シリコン単結晶薄板320の両面に、マスク層350（例えば、レジスト等）を成膜し、図13に示す形態の単結晶薄板320形成用のパターンングをフォトリソグラフィ技術で行う（e）。

【0087】

6. ICP-RIEのようなエッティング法を用いて、両面より一定の深さまで垂直エッティングを行う（f）。この深さは、断面がH字形状のトーションバー328、329の中央の架橋部の厚さを規定するものである。この深さの倍がこの架橋部の厚さとなる。

7. マスク層350を除去し、新たなマスク層351を成膜、及びパターンングする（g）。

【0088】

8. ICP-RIEのようなエッティング法を用いて、下面より垂直エッティングを行う

。エッティングは、最も深い部位がシリコン単結晶薄板320の中央に達するまで行う(h)。

【0089】

9. 更に、ICP-RIEのようなエッティング法を用いて、上面より垂直エッティングを行う。エッティングは、最も深い部位がシリコン単結晶薄板320を貫通するまで行う(i)。トーションバー328、329の部分では、H字形状のトーションバー328、329の所定の厚さの架橋部を残した所で止る。H字形状のトーションバー328、329の両側の柱部の厚さ(典型的には架橋部の厚さと等しい)はマスク層351の上下両面の一対のストライプ部の幅で規定される。

10. 最後に、マスク層351を除去する(j)。

【0090】

次に、図19を用いて、ガラス基板340の加工方法を説明する。図19は、図13の切断線307における断面図である。

【0091】

1. ガラス基板340の片面に種電極層370を成膜する(a)。
2. 種電極層370の上に厚膜レジスト層371を成膜し、固定コイル342形成用のパターニングを行う(b)。
3. 種電極層370の上に、コイル345の下配線層372を電解メッキで成膜する(c)。
4. 下配線層372部分以外の厚膜レジスト層371と種電極層370を除去する(d)。
5. 下配線層372の上に、絶縁層373を成膜し、両側部の配線層382、383形成用のパターニングを行う(e)。

【0092】

6. 絶縁層373の上に、種電極層374を成膜する(f)。
7. 種電極層374の上に厚膜レジスト層375を成膜し、固定コア342である軟磁性体層376と両側部の配線層382、383を形成できる様にパターニングを行う(g)。
8. 厚膜レジスト層375の無い種電極層374の部分上に、軟磁性体層37

6と両側部の配線層382、383を電解メッキで成膜する(h)。

9. 厚膜レジスト層375と種電極層374を除去する(i)。

10. 再び絶縁層377を成膜し、上配線層380形成用のパターニングを行う(j)。このパターニングで、絶縁層377は両側部の配線層382、383の頂部の所のみ除かれている。

【0093】

11. 絶縁層377の上に、種電極層378を成膜する(k)。

12. 種電極層378の上に厚膜レジスト層379を成膜し、パターニングを行う(l)。このパターニングで、厚膜レジスト層379は両側部の配線層382、383の外部の所のみ除かれている。

13. 種電極層378の上に、上配線層380を電解メッキで成膜する(m)

14. 最後に、厚膜レジスト層379と種電極層378を除去する(n)。

【0094】

最終的に、図13に示すような光偏向器の形態になるように、シリコン単結晶薄板320とガラス基板340を接合する。

【0095】

本実施例の特徴である、図16のようなH字形状断面を有するトーションバーにおいても、ねじれやすくて、撓みにくいという特徴がある。また、本実施例においても、揺動時に可動部がねじりの軸に垂直な方向に振動しにくくなるため、精度が高く、外乱の影響を受けにくい光偏向器を実現でき、従来よりも機械的なQ値が高いため、共振駆動を行ったときに、振幅が大きくエネルギー効率が高い。

【0096】

[実施例4]

図20は、実施例4の光走査型ディスプレイを説明する図である。X光偏向器401とY光偏向器402は、実施例3の光偏向器と同様のものである。コントローラ409は、X光偏向器401とY光偏向器402を制御して、レーザ光線410をラスター状に走査し、表示する情報に応じてレーザ発振器405を変調

することで、スクリーン407上に画像を2次元的に表示する。

【0097】

本発明の光偏向器を光走査型ディスプレイに適用することで、画像のぶれが少なく、エネルギー効率が高い光走査型ディスプレイを実現できる。

【0098】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、トーションバーの横断面形状が略多角形であり、その少なくとも2つ以上の内角が180度よりも大きく、また、前記横断面形状が点対称形状であるので、ねじれやすく撓みにくくて、ねじれの軸に垂直な方向に加振力が生じることのないトーションバーを持つマイクロ構造体を提供することができる。

【0099】

また、揺動したときに、ねじれの軸に垂直な方向に加振力が生じることがないため、ノイズの少ないマイクロ力学量センサを提供でき、単結晶材料を用いる場合は機械的なQ値が高いために、ノイズが少なく、感度の高い、力学量センサを提供できる。また、揺動したときに、ねじれの軸に垂直な方向に加振力が生じることがないため、不要な方向の動きの少ないマイクロアクチュエータを提供でき、単結晶材料を用いる場合は機械的なQ値が高いため、共振駆動したときに振幅が大きく、また、エネルギー効率の高いマイクロアクチュエータを提供できる。また、揺動したときに、ねじれの軸に垂直な方向に加振力が生じることがないため、走査光のぶれが少ないマイクロ光偏向器を提供でき、単結晶材料を用いる場合は機械的なQ値が高いため、共振駆動したときに振幅が大きく、また、エネルギー効率の高いマイクロ光偏向器を提供できる。

【0100】

また、本発明によれば、揺動したときに、ねじれの軸に垂直な方向に加振力が生じることがないため、走査光のぶれが少ない光走査型ディスプレイを提供でき、単結晶材料を用いる場合は機械的なQ値が高いため、エネルギー効率が高い光走査型ディスプレイを実現できる。

【0101】

更に、本発明の製造方法を用いることで、本発明のマイクロ構造体、マイクロ光偏向器、マイクロ力学量センサ及びマイクロアクチュエータを比較的容易に製造できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施例1の光偏向器を説明するための斜視図である。

【図2】

実施例1の光偏向器を説明するための分解図(a)、及びトーションバーの縦断面図(b)である。

【図3】

実施例1の光偏向器を説明するためのトーションバーの部分の横断面図である

【図4】

実施例1の光偏向器を説明するための平面図である。

【図5】

シリコンの異方性エッチングを説明する図である。

【図6】

実施例1の光偏向器のシリコン単結晶薄板の作製プロセスを説明する図である

【図7】

実施例1の光偏向器のガラス基板の作製プロセスを説明する図である。

【図8】

本発明の実施例2の加速度センサを説明するための斜視図である。

【図9】

実施例2の加速度センサを説明するための分解図である。

【図10】

実施例2の加速度センサを説明するためのトーションバーの部分の横断面図である。

【図11】

実施例2の加速度センサのシリコン単結晶薄板の作製プロセスを説明する図である。

【図12】

実施例2の加速度センサのガラス基板の作製プロセスを説明する図である。

【図13】

本発明の実施例3の光偏向器を説明する斜視図である。

【図14】

実施例3の光偏向器を説明する上面図である。

【図15】

実施例3の光偏向器を説明する一部破断した側面図である。

【図16】

実施例3の光偏向器のトーションバーを説明する断面図である。

【図17】

実施例3の光偏向器の動作原理を説明する図である。

【図18】

実施例3の光偏向器のシリコン単結晶薄板の作製プロセスを説明する図である

【図19】

実施例3の光偏向器の固定コアとコイルの作製プロセスを説明する図である。

【図20】

本発明の実施例4の光走査型ディスプレイを説明する図である。

【図21】

本発明のトーションバーの例の断面形状を説明する図である。

【図22】

T字状断面形状のトーションバーを説明する斜視図である。

【図23】

T字状断面形状のトーションバーを説明する断面図である。

【図24】

従来の光偏向器を説明するための斜視図である。

【図25】

従来の光偏向器を説明するための分解図である。

【図26】

従来の光偏向器を説明するための断面図である。

【図27】

従来の光偏向器を説明するためのトーションバーの部分の断面図である。

【図28】

従来のハードディスク用ジンバルを説明する上面図である。

【図29】

従来のハードディスク用ジンバルを説明するための断面図である。

【図30】

従来のハードディスク用ジンバルの作製プロセスを説明する図である。

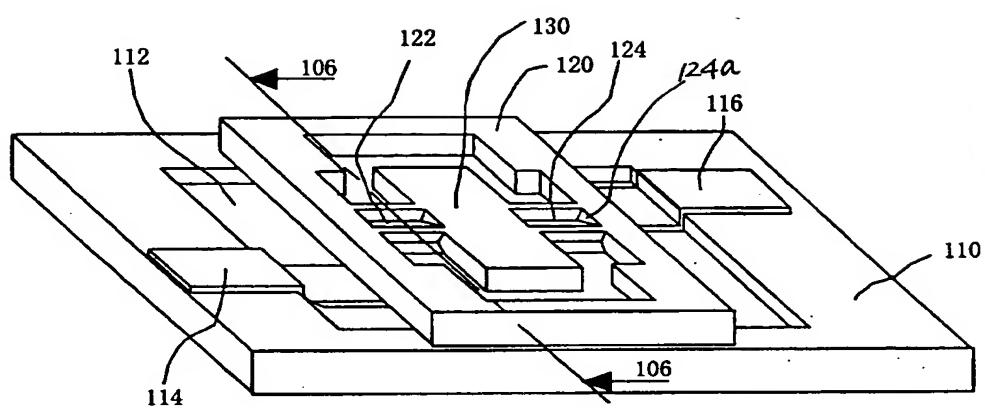
【符号の説明】

110、210、340	ガラス基板
112、212	凹み部
114、116	駆動電極
120、220、320	シリコン単結晶薄板
122、124、222、224、328、329	トーションバー
122a、124a	トーションバーの付け根部の斜面
130、330	ミラー
132	ミラー支持部
150、250、251、350	マスク層
216	検出電極
230	揺動部材
341	可動コア
342	固定コア
345	コイル
360、370、374、378	種電極層
362、376	軟磁性体層

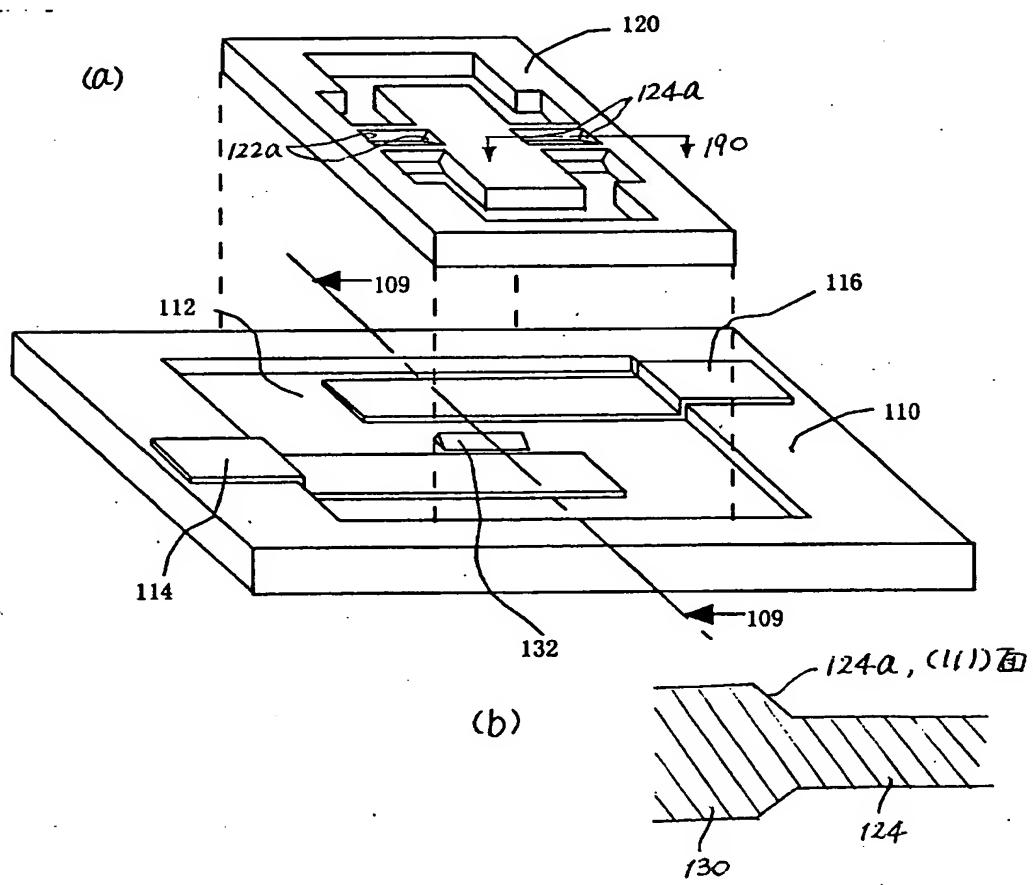
361、371、375、379 厚膜レジスト層
 372 下配線層
 373、377 絶縁層
 380 上配線層
 382、383 側部配線層
 401 X光偏向器
 402 Y光偏向器
 405 レーザ発振器
 407 スクリーン
 409 コントローラ
 410 レーザ光線
 1010 絶縁性基板
 1014、1016 駆動電極
 1020 シリコン薄板
 1022、1024、2001、2002 トーションバー
 1030、2011 ミラー
 1032 ミラー支持部
 2020 ジンバル
 2022、2024 ロールトーションバー
 2026、2028 ピッチトーションバー
 2030 ヘッド支持体
 2031 支持枠
 2091 型取り用シリコンウェハー
 2092 牺牲層
 2093 ポリシリコン層
 2094 エポキシ樹脂
 2095 パッド

【書類名】 図面

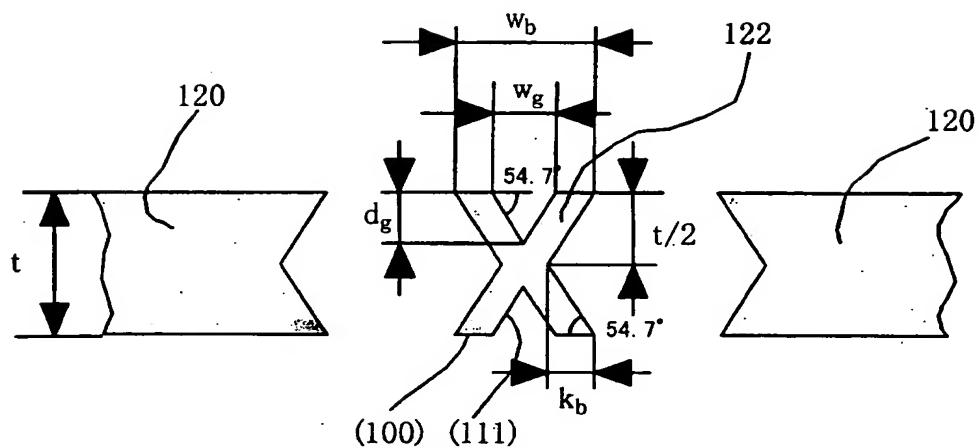
【図1】



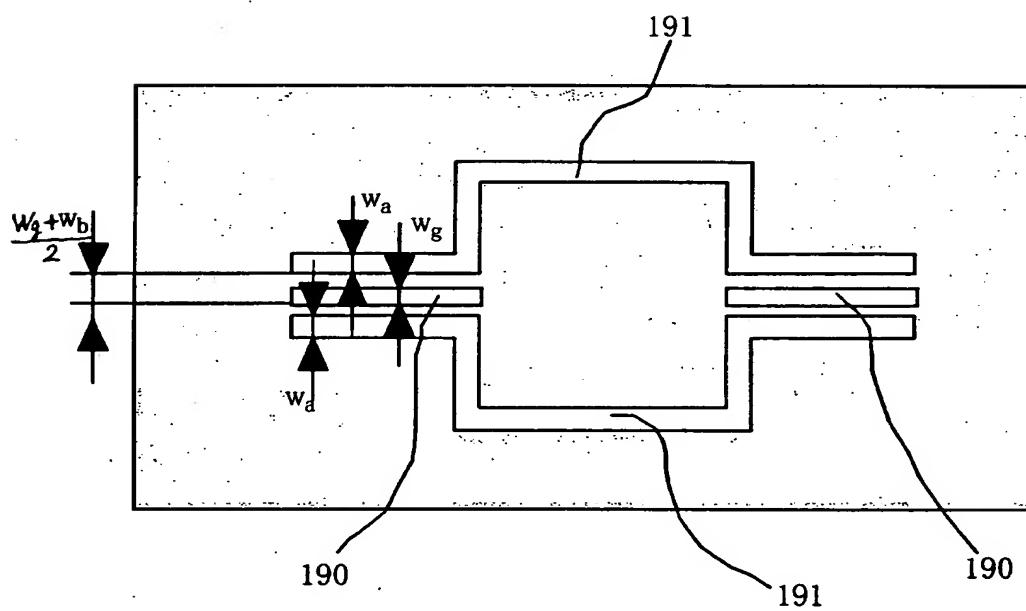
【図2】



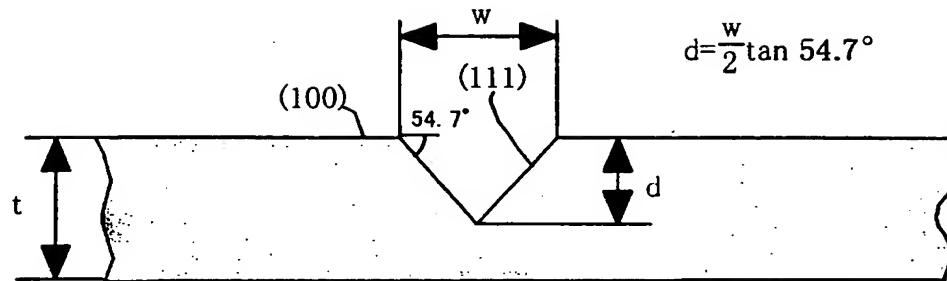
【図3】



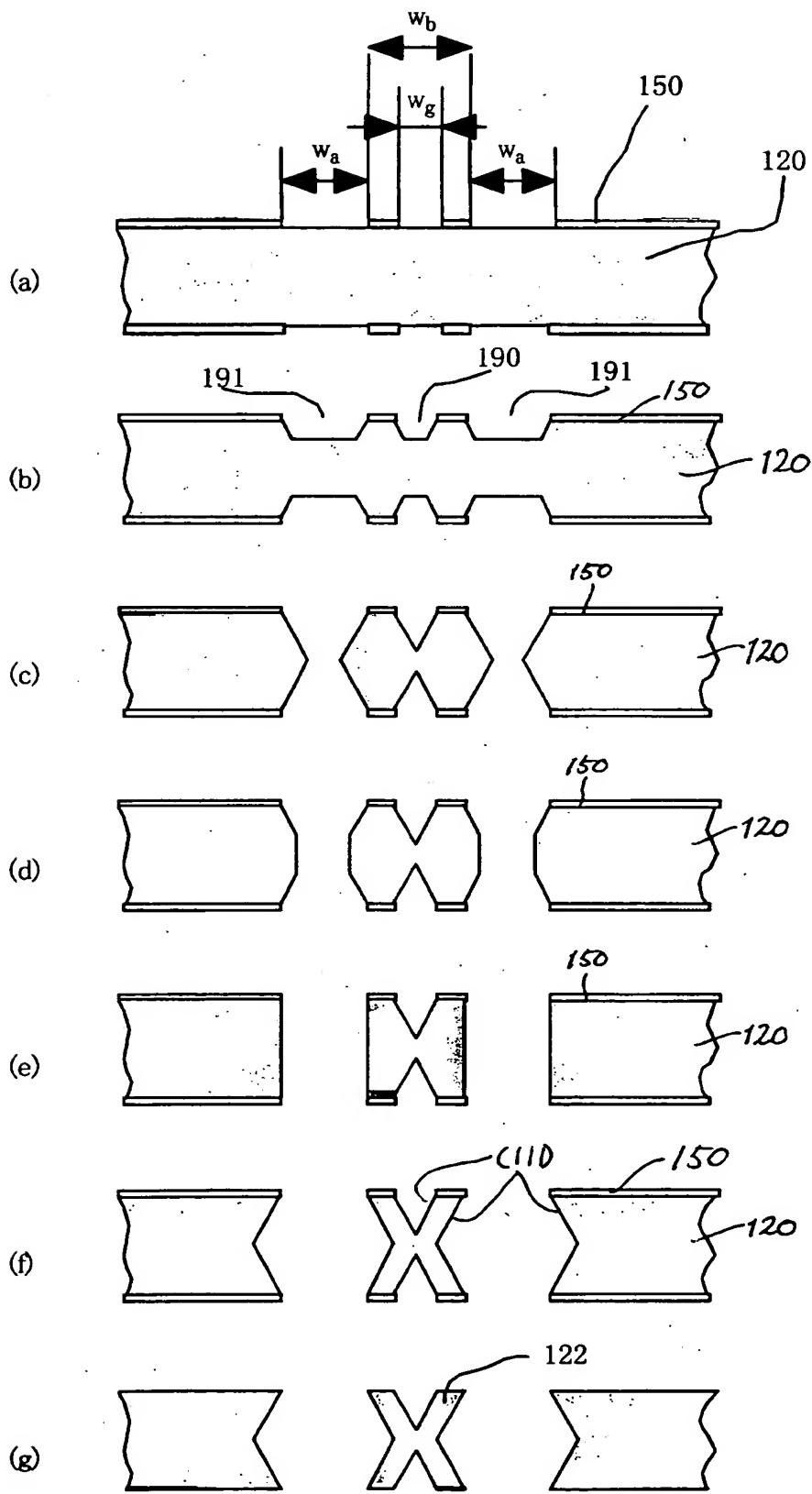
【図4】



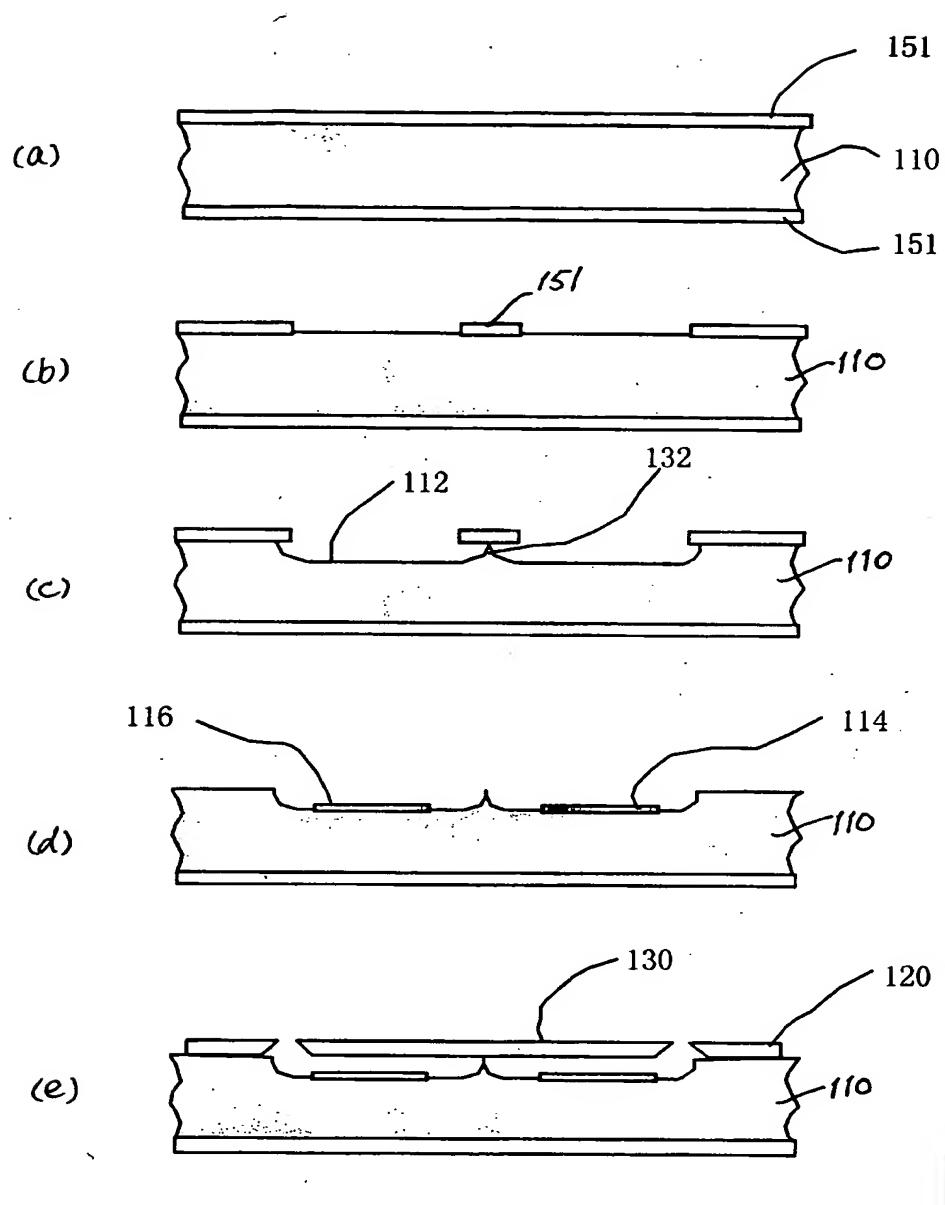
【図5】



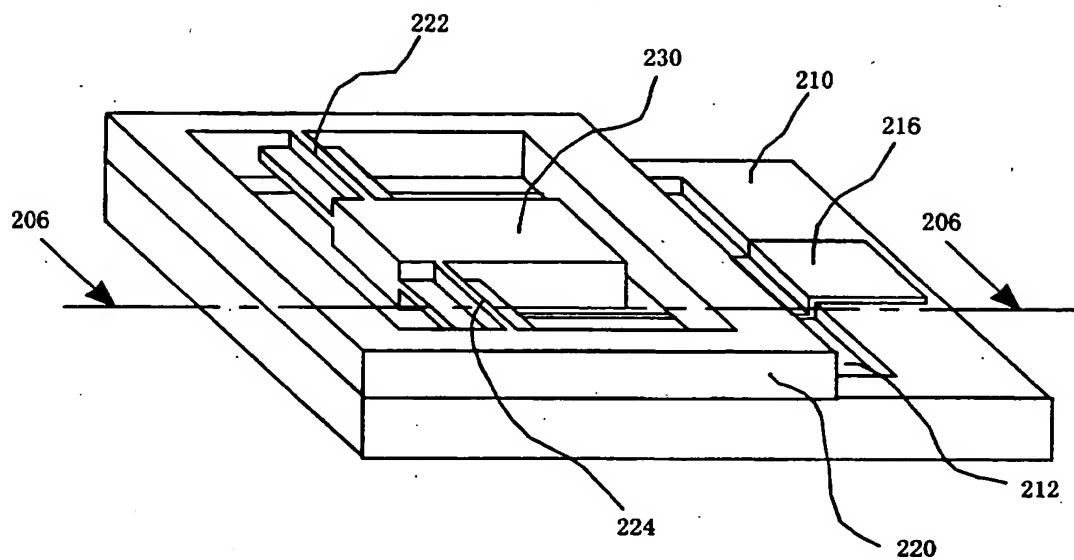
【図6】



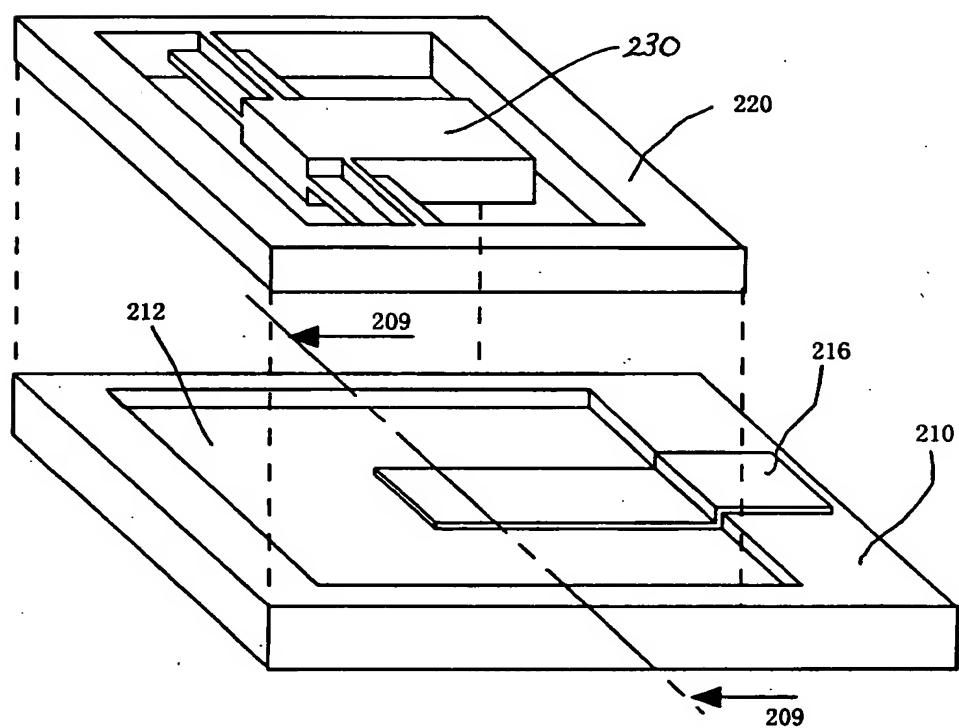
【図7】



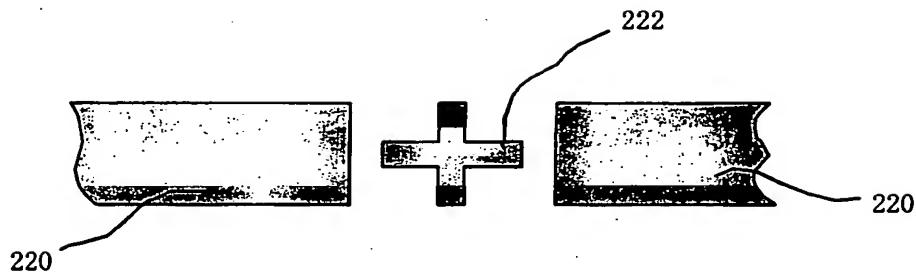
【図8】



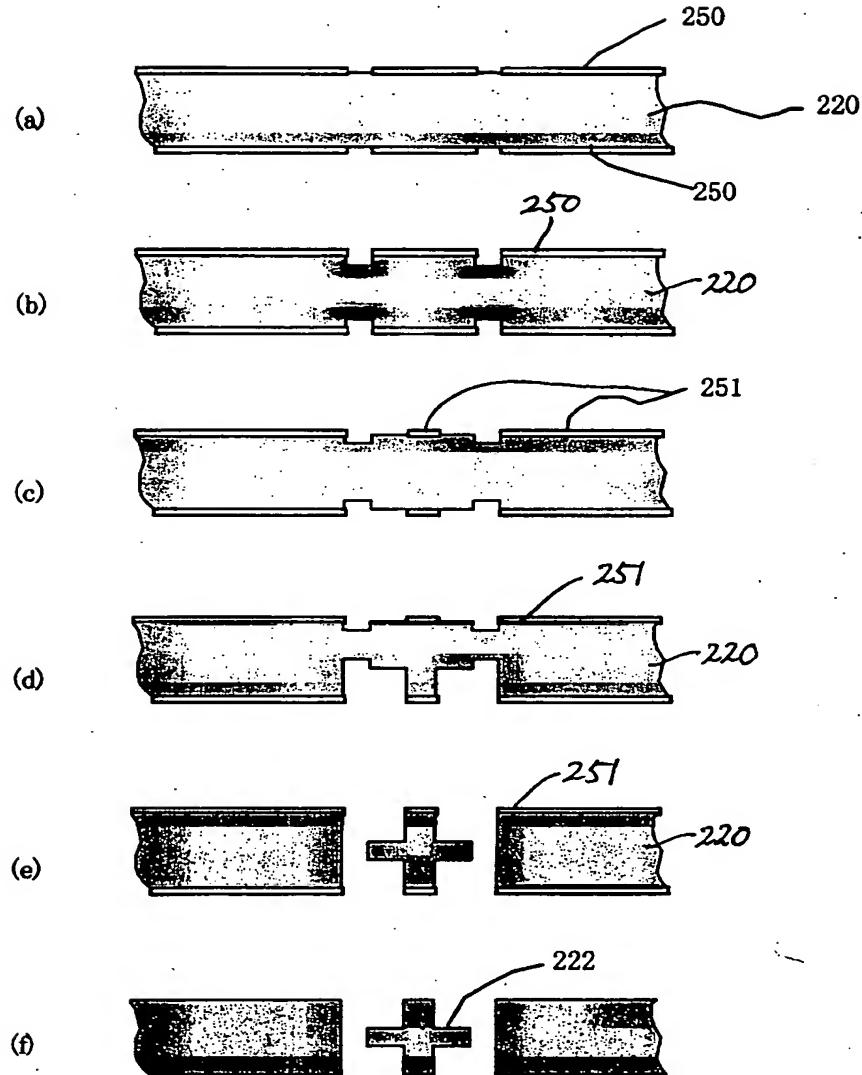
【図9】



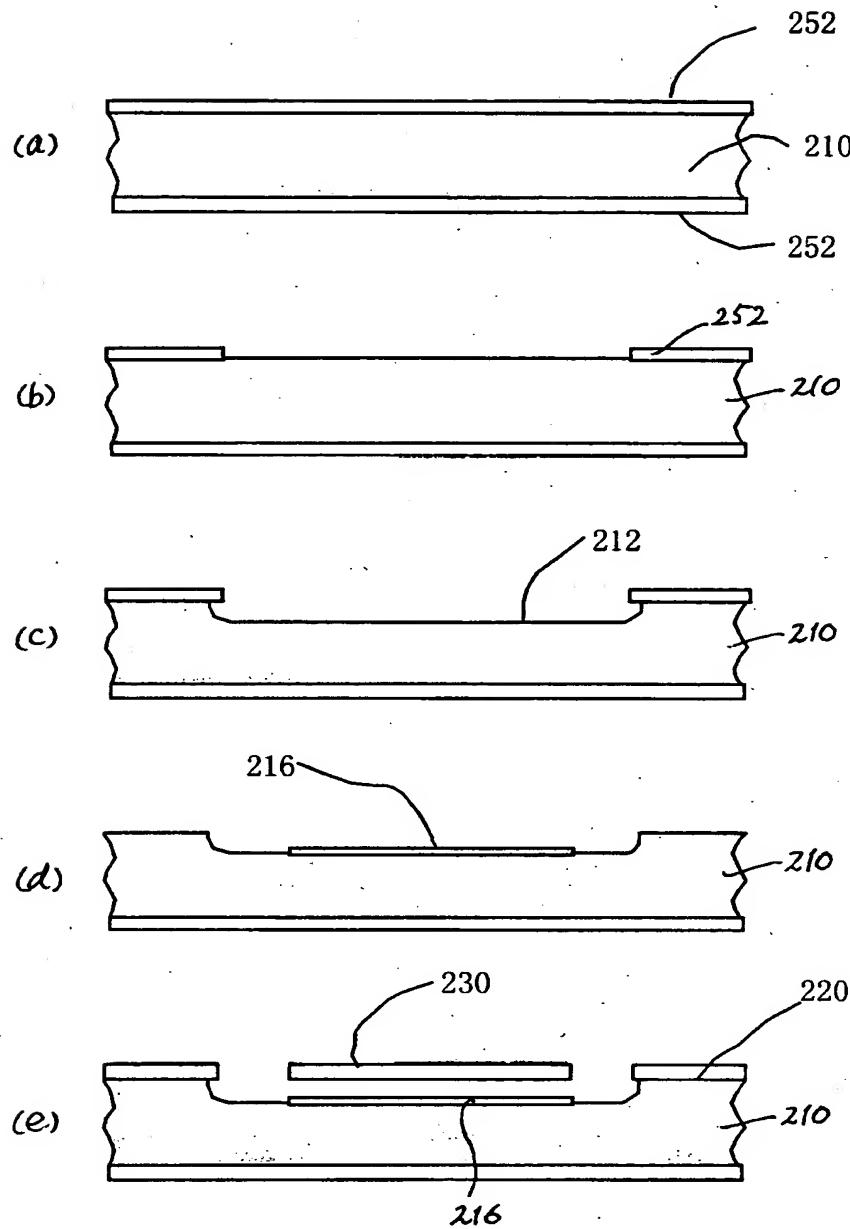
【図10】



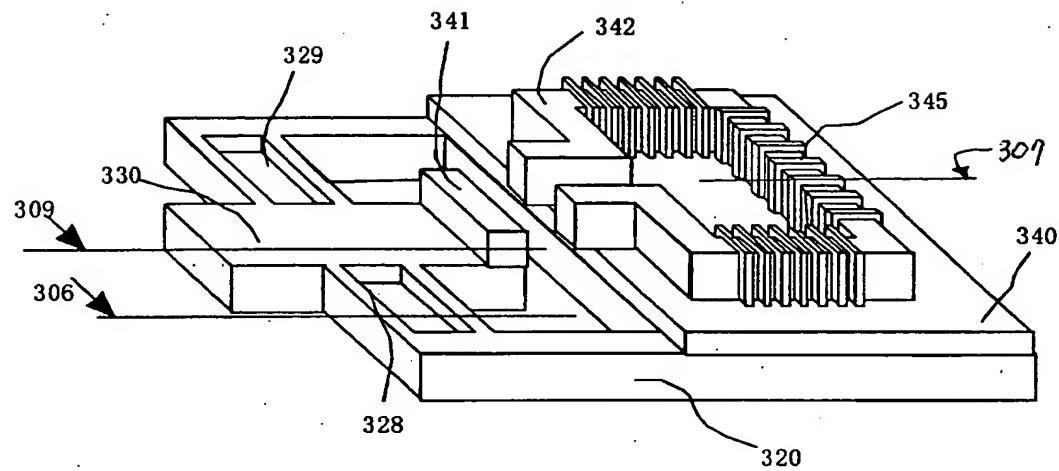
【図11】



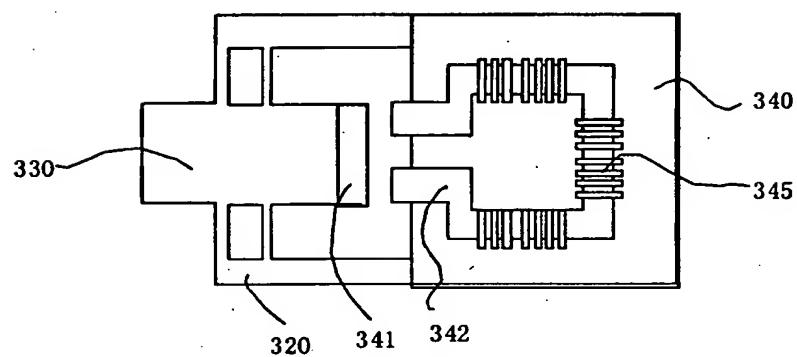
【図12】



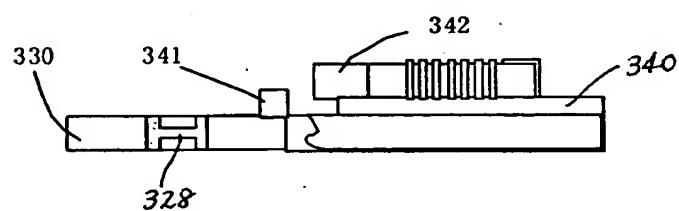
【図13】



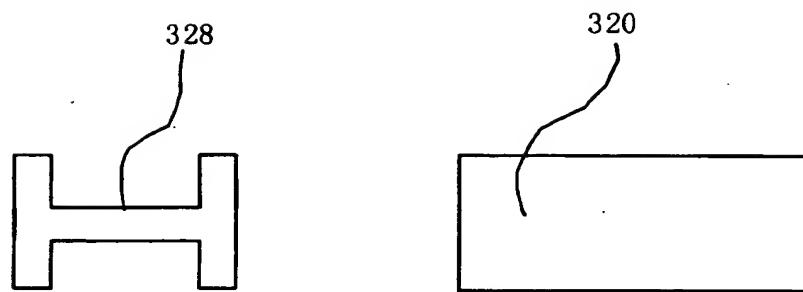
【図14】



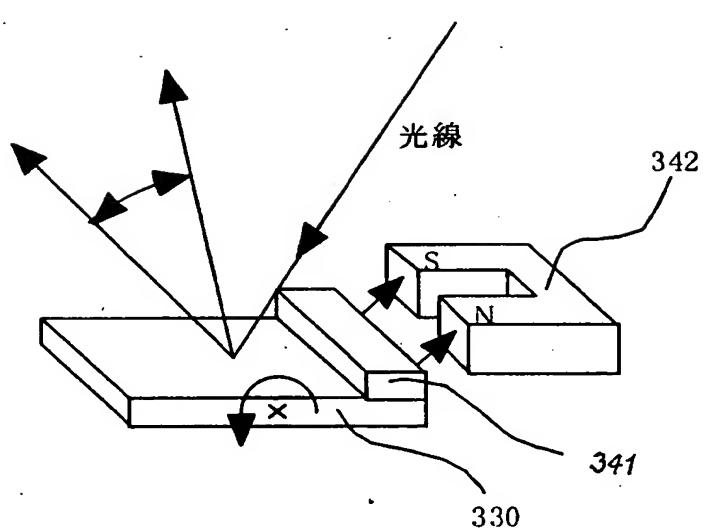
【図15】



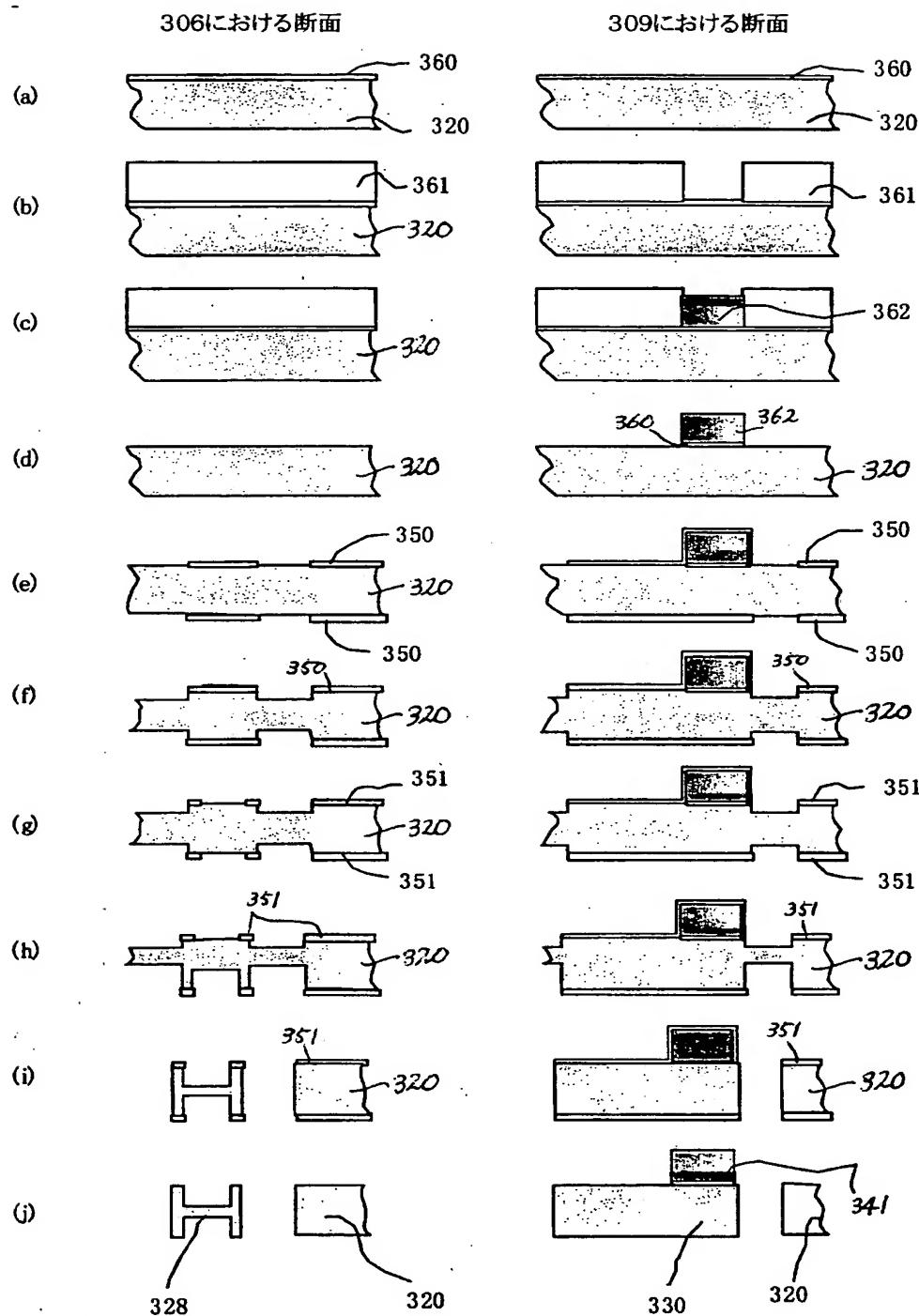
【図16】



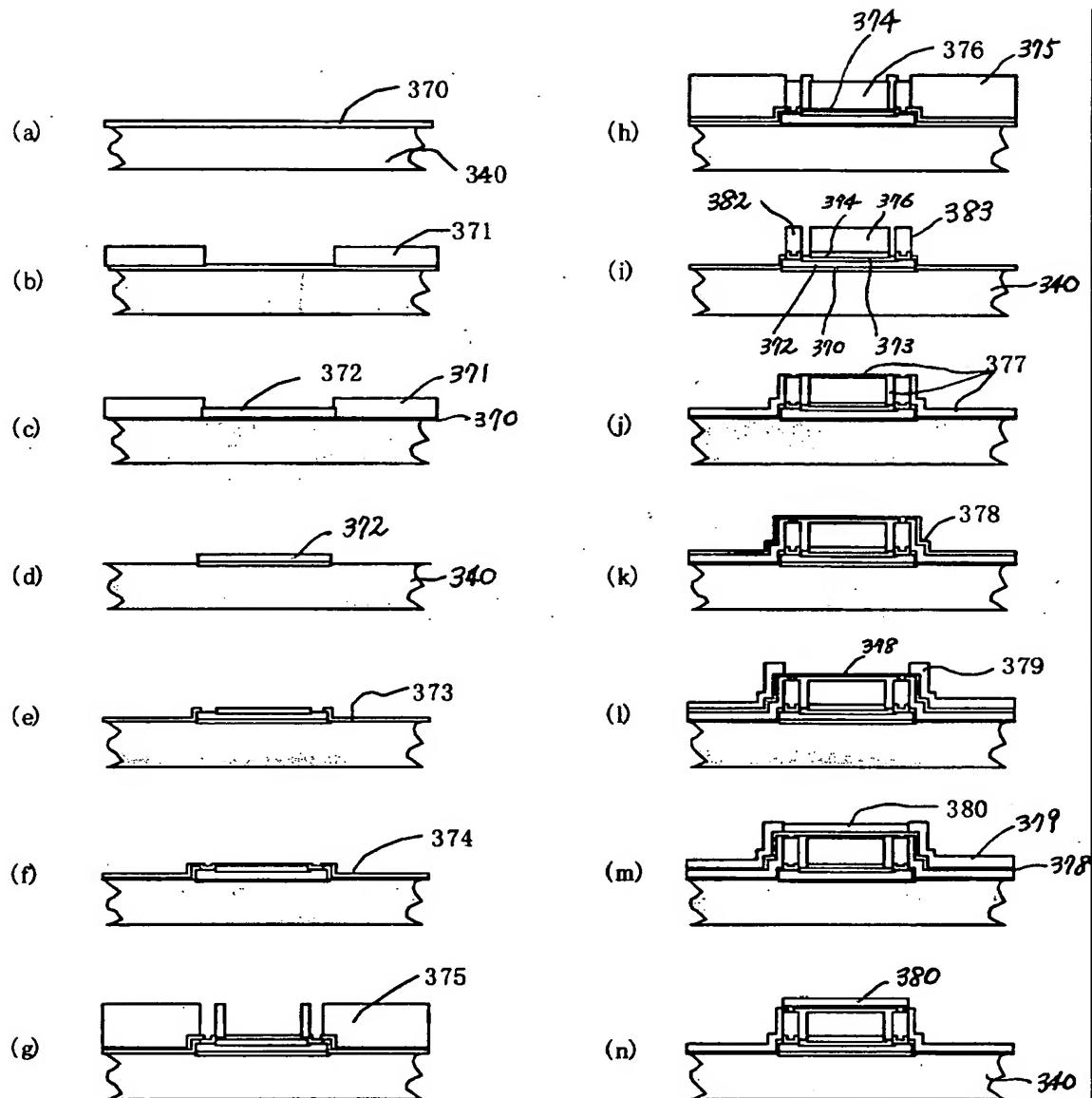
【図17】



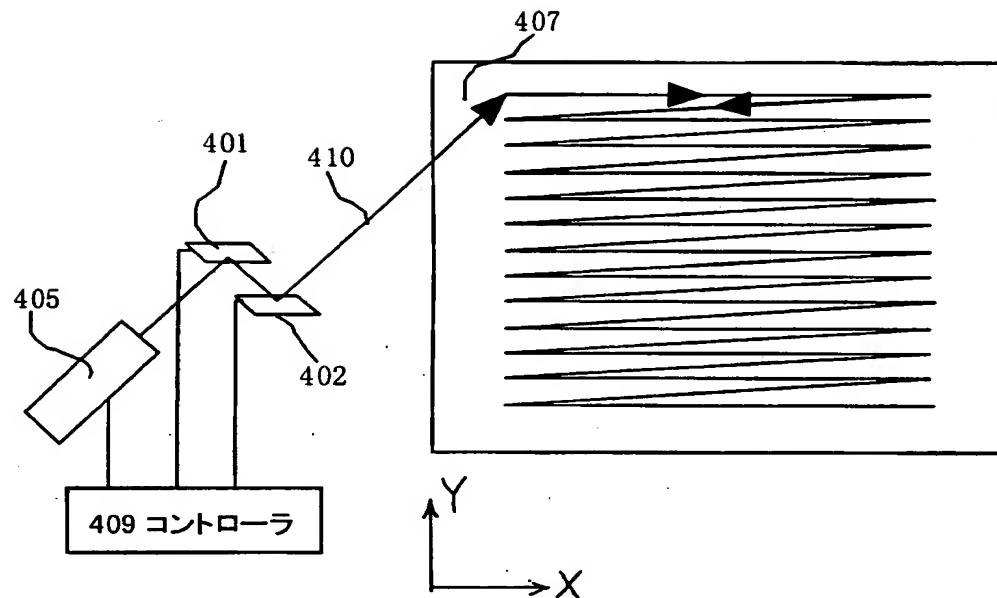
【図18】



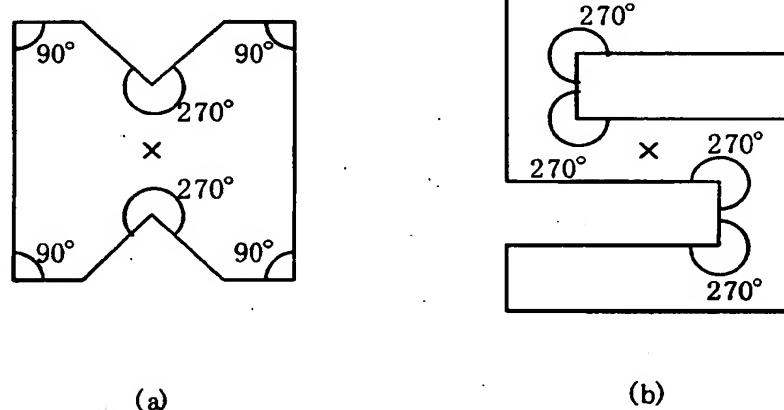
【図19】



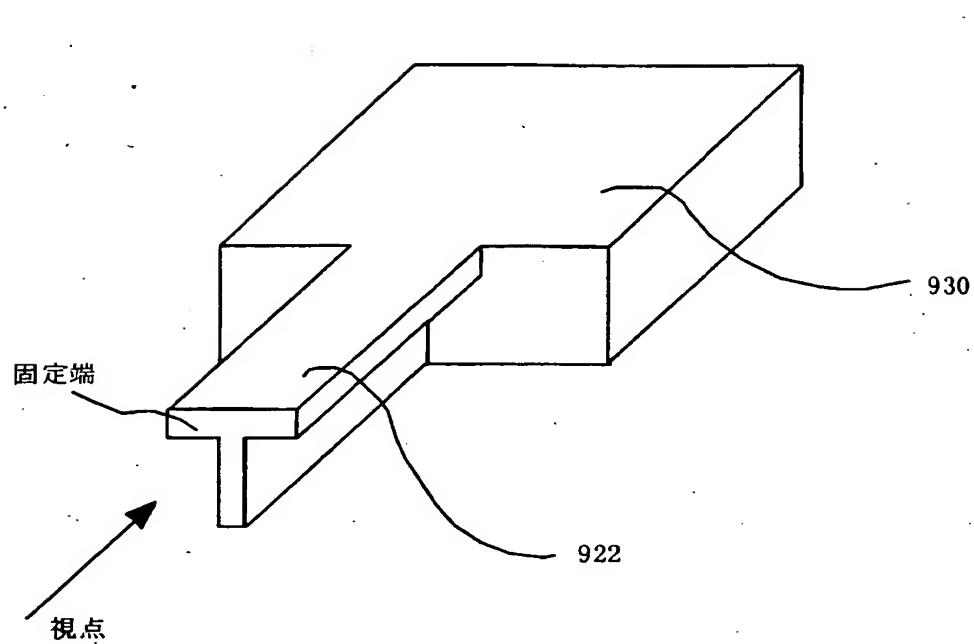
【図20】



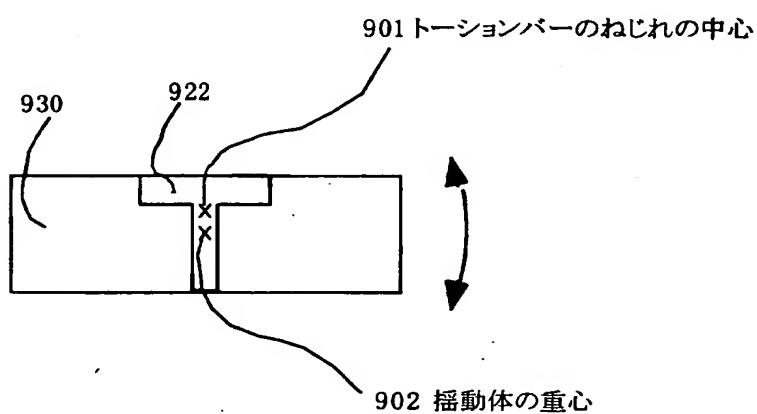
【図21】



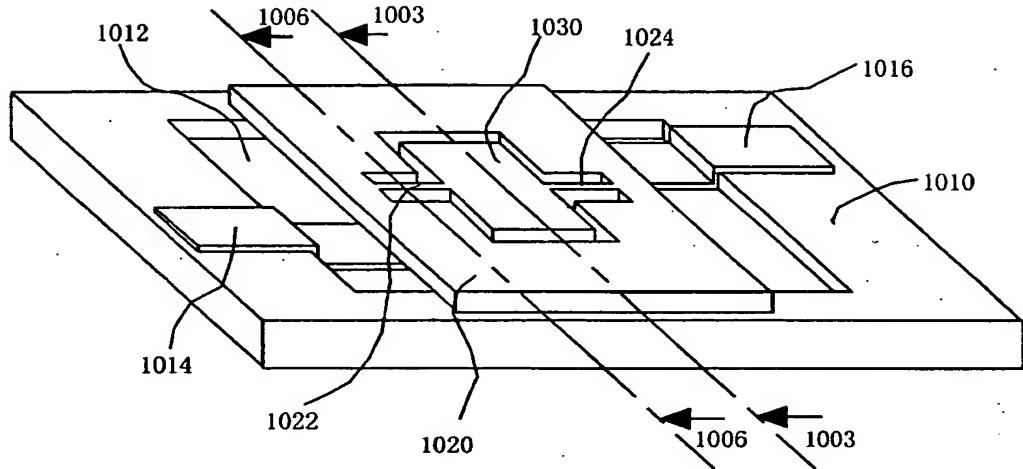
【図22】



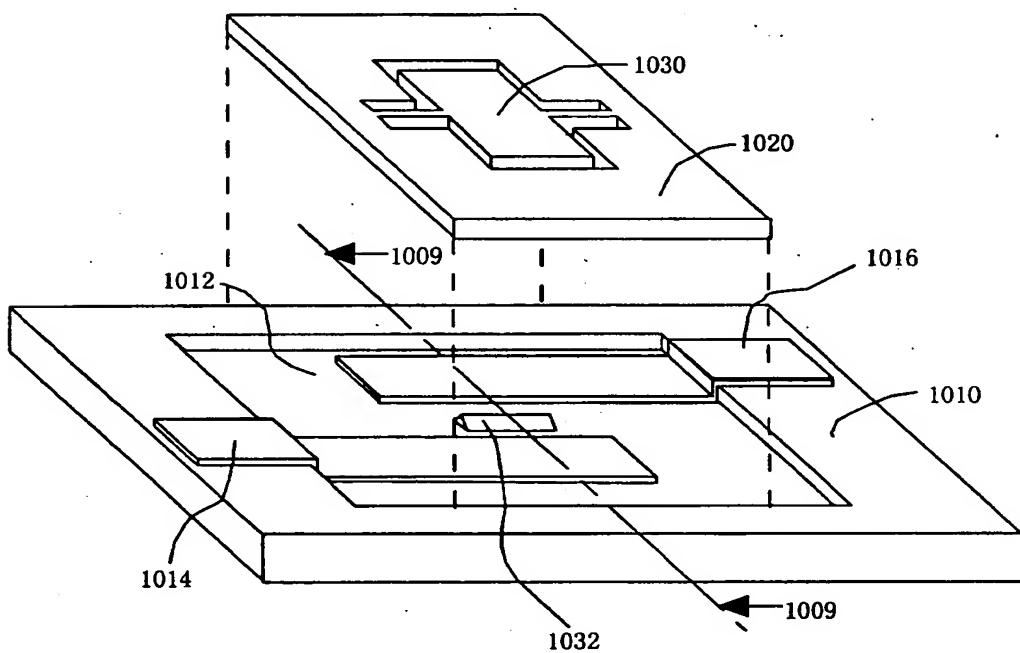
【図23】



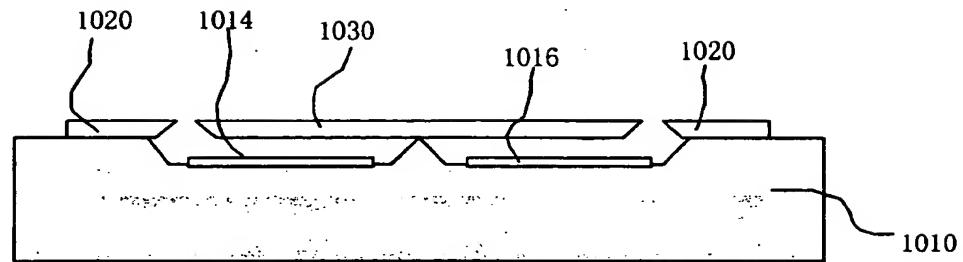
【図24】



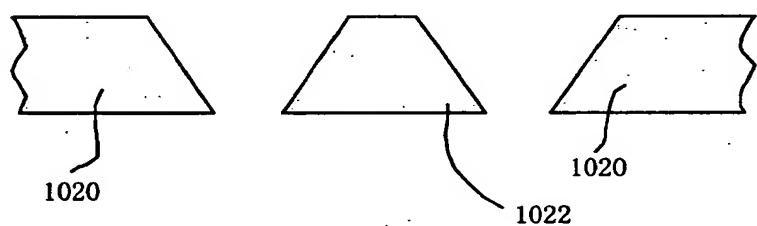
【図25】



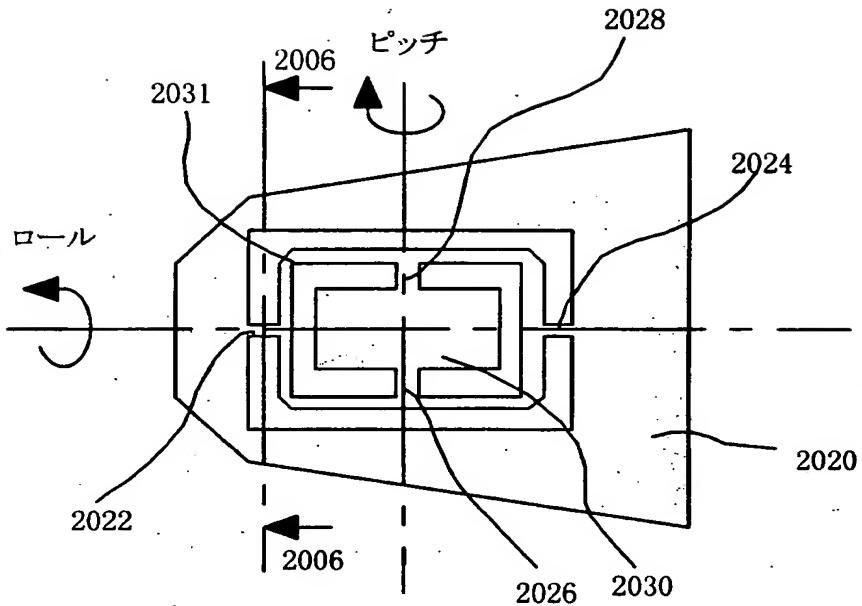
【図26】



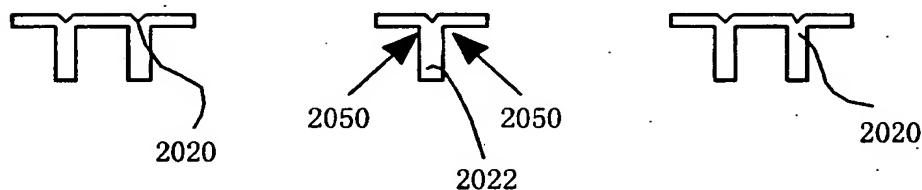
【図27】



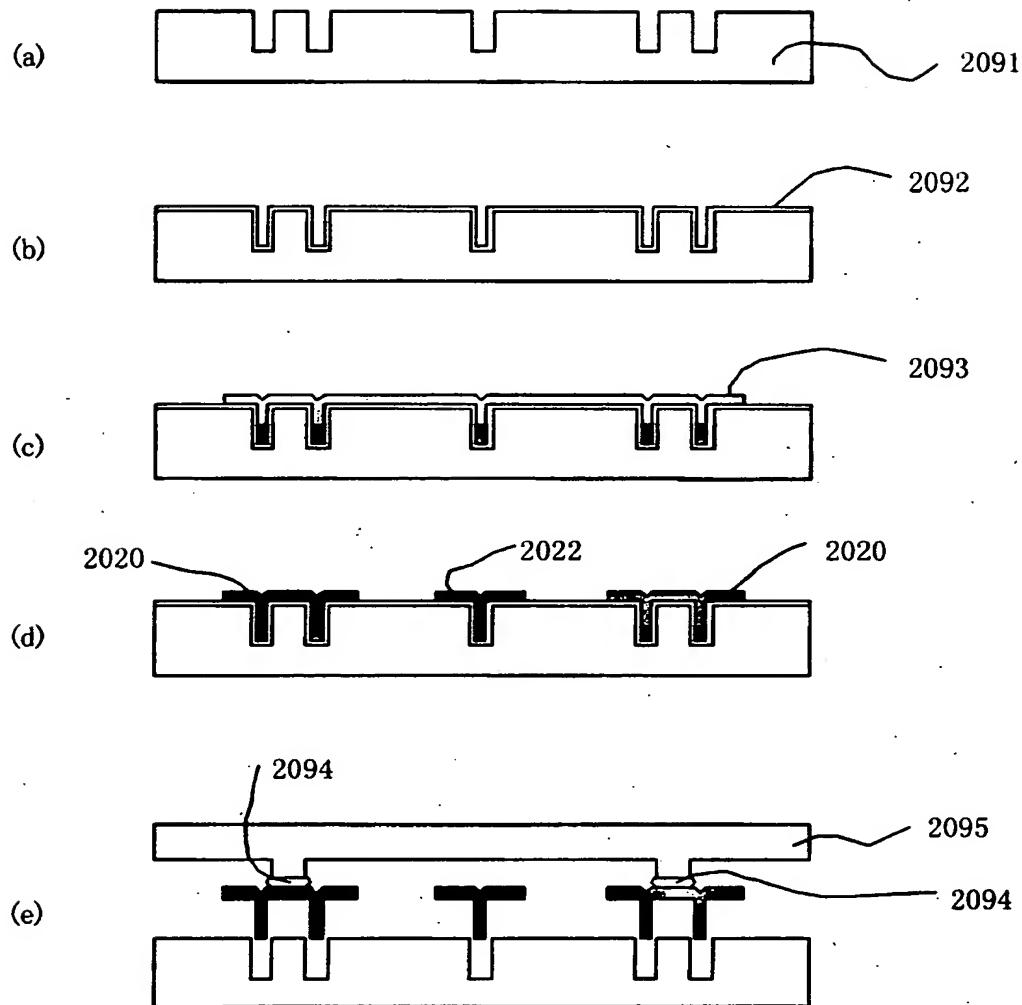
【図28】



【図29】



【図30】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 比較的ねじれやすくて、ねじれの軸に角度を成す方向に対して撓みにくいトーションバーで揺動自由に支持された揺動体を有するマイクロ構造体である。

【解決手段】 マイクロ構造体は、基板120と、少なくとも一つ以上の揺動体130を有し、揺動体130が1本以上のトーションバー122、124によって基板120に対して弾性的に揺動自由に支持されている。トーションバー122、124は、横断面形状が略多角形であり、その少なくとも2つ以上の内角が180度よりも大きく、また、横断面形状が点対称形状である。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社